

1-215464-2 ✓ 有效

Micro-MaTch | Micro-MaTch Industrial

TE 内部编号 1-215464-2

Micro-MaTch Industrial, Ribbon Cable Connectors, Board-to-Board,  
12 Position, 1.27mm [.05in] Centerline, Vertical, Through Hole -  
Solder

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [线对板连接器](#) > [FFC、FPC 和带状连接器](#) > [带状电缆连接器](#) > [板公端连接器](#)



连接器系统: **板对板**

Number of Positions: 12

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装固定: **带有**

PCB 安装固定类型: **扭结焊尾**

[所有 板公端连接器 \(36\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

Number of Positions	12
PCB 安装方向	垂直
行数	2

### 电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
Operating Voltage	100 VAC

### 主体特性

菊花链	不带
连接器外形	标准

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 $\mu\text{m}$ [118.11 – 196.85 $\mu\text{in}$ ]
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
对接公端厚度	.4 mm[.016 in]
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 5 $\mu\text{m}$ [118.11 – 196.85 $\mu\text{in}$ ]
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	1.5 A

### 端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.015 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

接合对准	带有
壳体内部的端子定位器类型	压接
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	接触件摩擦
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT GF
壳体颜色	红色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

### 尺寸



连接器长度	13.97 mm[.55 in]
连接器高度	6.9 mm[.27 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.062 in]
Row-to-Row Spacing	2 mm[.059 in]

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

### 行业标准

UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205) 超过限值的SVHC : Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

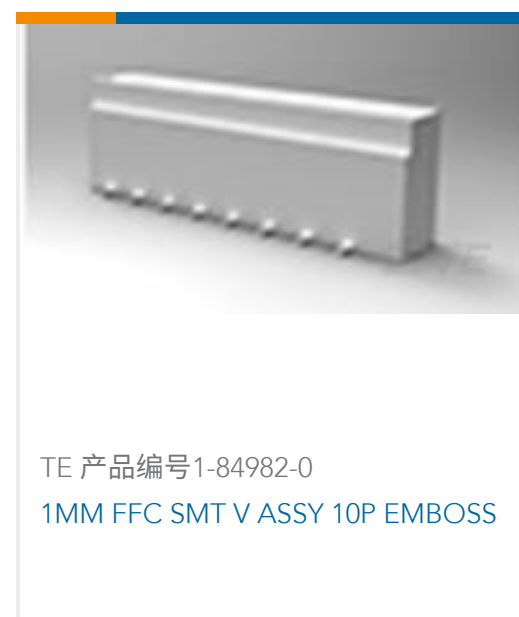
## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Micro-MaTch Industrial



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

12P.MICRO-MATCH MOB

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215464-2\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215464-2\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215464-2\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



**数据表/目录页**

[Micro-MaTch Catalog](#)

英文版本

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

[Centerline Micro-Match Connector Series](#)

英文版本

---

**产品规格**

[产品规格](#)

英文版本

---

**机构认证**

[UL 报告](#)

英文版本